

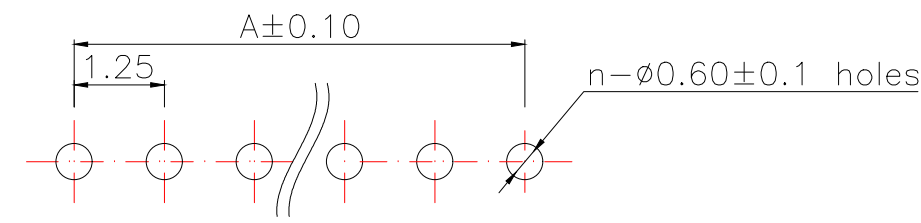
Part No	Pin	A	B
WAFER-MX1.25B-2PZZ	2	1.25	4.30
WAFER-MX1.25B-3PZZ	3	2.50	5.55
WAFER-MX1.25B-4PZZ	4	3.75	6.80
WAFER-MX1.25B-5PZZ	5	5.00	8.05
WAFER-MX1.25B-6PZZ	6	6.25	9.30
WAFER-MX1.25B-7PZZ	7	7.50	10.55
WAFER-MX1.25B-8PZZ	8	8.75	11.80
WAFER-MX1.25B-9PZZ	9	10.00	13.05
WAFER-MX1.25B-10PZZ	10	11.25	14.30
WAFER-MX1.25B-11PZZ	11	12.50	15.55
WAFER-MX1.25B-12PZZ	12	13.75	16.80
WAFER-MX1.25B-13PZZ	13	15.00	18.05
WAFER-MX1.25B-14PZZ	14	16.25	19.30
WAFER-MX1.25B-15PZZ	15	17.50	20.55
WAFER-MX1.25B-16PZZ	16	18.75	21.80

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁,无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围: -25°C~85°C;
- 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
- 4、额定电流: 1A
- 5、接触电阻: ≤0.03Ω;
- 6、绝缘电阻: ≥1000MΩ;
- 7、耐压: 1000V, AC/minute.

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质.
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据,不可测定物质的成分表,有效期一年.



PCB寸法
PCB Layout

2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u".MIN.
1	基座 Wafer	PA66(UL94 V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	附注

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: WAFER-MX1.25B-直针
DECIMALS:	ANGLES:		PAR WAFER-MX1.25B-NPZZ
.X:±0.10	X.:±5°		DWN Lucas
.XX:±0.05	X.X':±2'		CHKD Ethan
.XXX:±0.02		APVD Jacob	SCALE 1:1 UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A